

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司

关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为保证公司生产经营活动资金需求，公司积极拓展外部银行融资，预计 2023 年度向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元），有效期自股东大会审议通过之日起至下一年审批同等事项的相关会议召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。具体融资金额及担保方式、信贷业务品种、期限、利率以银行批复及公司与银行签订的合同约定为准。

二、向银行申请综合授信额度的必要性

公司 2023 年度向银行申请综合授信额度，是公司业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日